

共模电感失效分析，交变盐雾试验

产品名称	共模电感失效分析，交变盐雾试验
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

共模电感失效分析，交变盐雾试验

应力试验分析

元件失效一般与应力有关，包括温度，电压、电流、功率、湿度、机械振动、冲击、热冲击、温度循环等，可以通过应力试验评估产品的失效应力分布，确定产品的失效应力范围。

7.故障模拟分析

一般模拟分析包含模拟应用分析，全温度参数测试，瞬时短路、断路的试验分析，高温和高湿电偏置试验。

8.内部分析

分为非破坏性的内部分析和破坏性分析，内部分析包含X射线检查，声学扫描检查，残留气体检查，密封性检查，破坏性检查包含开封，失效点定位，芯片钝化层去除，物理分析，杂质和合成物分析。

9.纠正措施

根据失效分析结果，提出防止再次发生失效的措施与建议。

10.结果验证

失效结果正确与否，在实际应用中会得到验证，有利于采取有效措施防止类似失效再次发生，提高元件可靠性。

七.实例

一般集成封装器件，主要的失效模式和相关的失效机理如下：

- 1.开路 (EOS、ESD、电迁移、应力迁移、腐蚀、键合点脱落、机械应力、热变应力)
- 2.短路 (PN结缺陷、PN结穿钉、EOS、介质击穿、金属迁移)
- 3.参漂 (氧化层电荷、表面离子、芯片裂纹、热载流子、辐射损伤)
- 4.功能失效 (EOS、ESD)

实例一 浪涌损坏

样品为整流桥，在实验室做实验过程中，突然失效，有输入没输出，属于功能失效，主要原因是，浪涌损坏，主要是过大的电源电压使器件发生击穿，形成短路，造成大电流，导致整流桥内部电流过大，导致整流桥损坏。